

为新一代的移动出行带来变革！SEKISUI解决方案

Sekisui Mobility Solution



安全 (ADAS)



环境



设计/舒适

产品咨询

积水化学工业株式会社 高机能塑料事业领域 移动出行战略室



sekisui-auto@sekisui.com



粘接

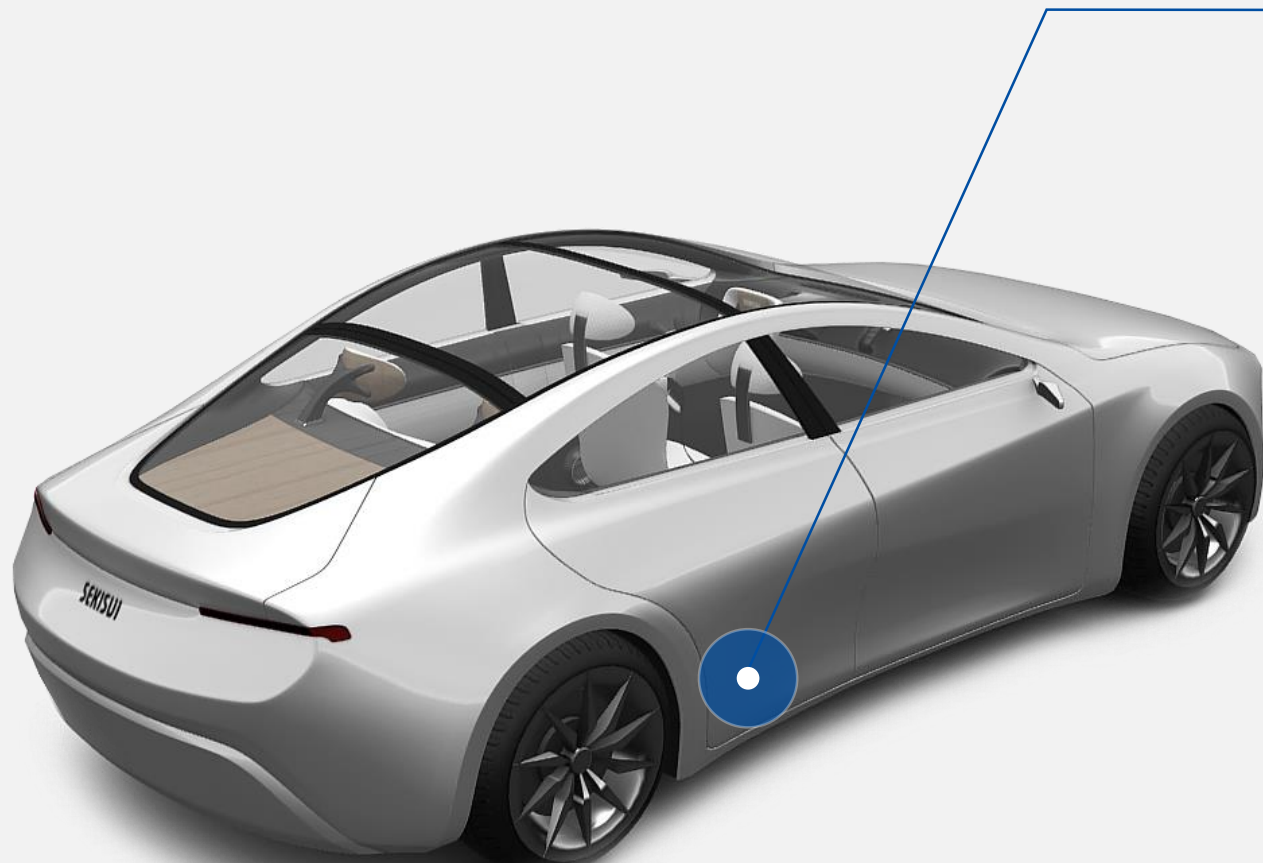
FA/FB系列 – 用于氟树脂的双面胶带

安全 (ADAS)

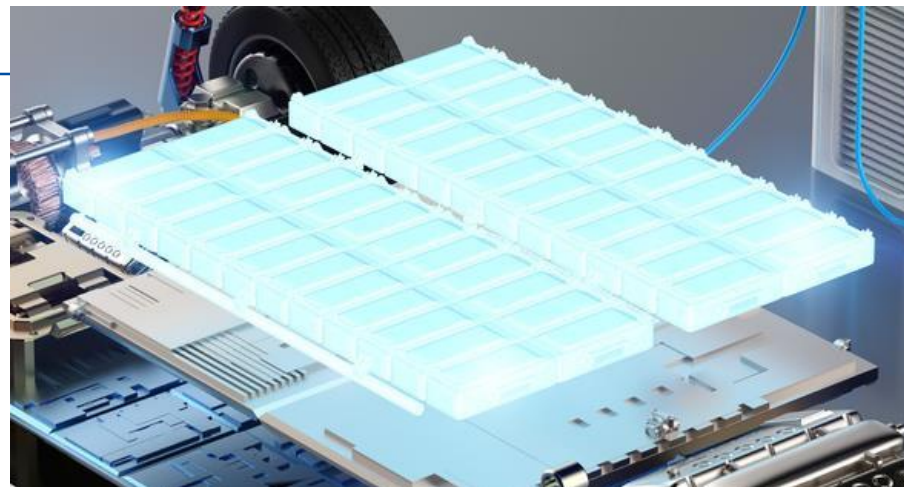
环境

设计/舒适

可牢固粘贴困难被粘物的胶带



用途示例：各种密封材料的固定



※示意图

产品





Challenge

需要进行表面primer处理的氟表面粘接

氟树脂因其分子中含有氟原子的高分子而具有耐热性、耐药性、电气特性、非粘接性、润滑性等特性。其独一无二的特性应用于防水涂层、不粘锅的防粘涂层，还期待可用作5G乃至将来6G时代的高频回路基板材料。但是，由于氟树脂的化学非活性导致它极其难以与其他物质粘接。当前，会在因非活性而不好粘接的氟树脂上进行被称为“primer”的粘接涂层处理，或者进行特殊等离子处理等，否则就会因其粘接面的非活性而无法发挥出令人满意的粘接力。





Solution

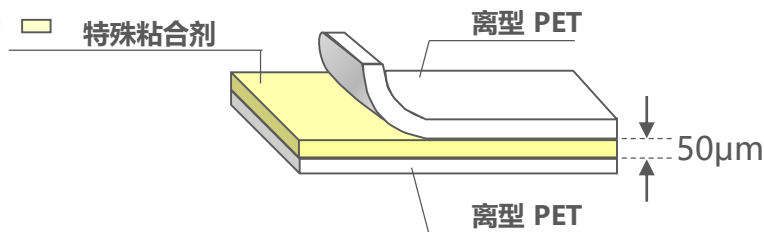
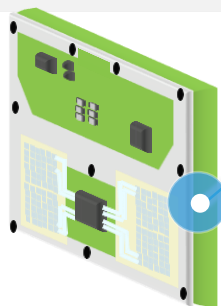
不需要primer处理的氟树脂用胶带

“用于氟树脂的双面胶带、FA/FB系列”使用特殊粘合剂，可以对以前不可能的氟树脂进行良好的粘接。而且，不需要进行让之容易粘接的primer处理。

和传统胶带相比，本胶带不仅对氟树脂，对于金属、玻璃、聚丙烯等材料的粘合力也有了很大提升，对很多目前为止被普遍认为难以粘接的材料都有良好的粘接性能，具有划时代意义。

今后，除了高速处理不断增长的信息通信量时所需的高频回路基板材料、高性能化的智能手机内部的被覆零部件及过滤器等的粘接，还有使用含有氟树脂的密封件等的工业机器及医疗用途等，本胶带一定会成为解决各领域课题的产品。





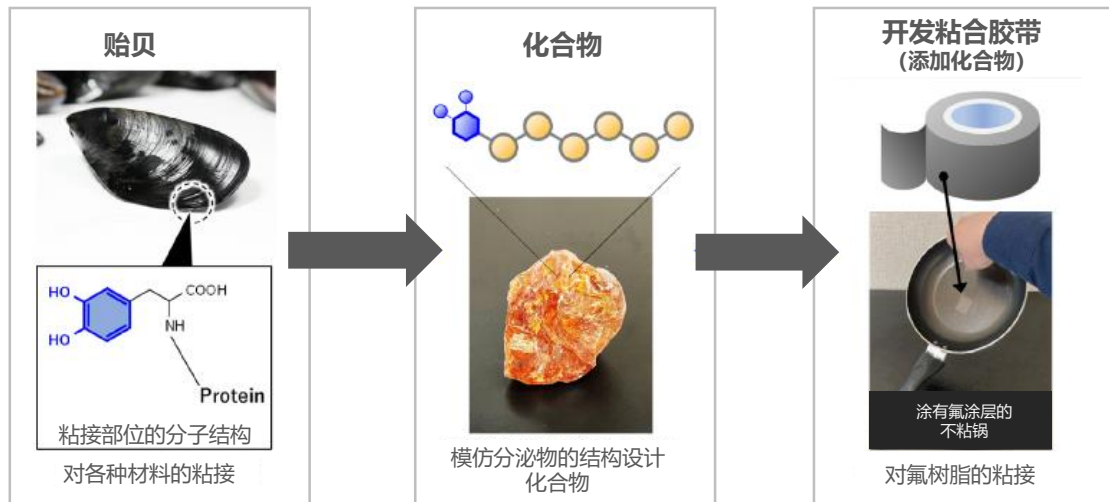
※示意图

技术概述

feature 01

对氟树脂与普遍认为难以粘接的
聚烯烃树脂都有很强粘接力

以贻贝为灵感开发的化合物



feature 02

粘接时不需要加热或primer等
特殊处理的感压式粘合胶带

1. 不需要加热
 2. 不需要表面处理
- 与普通双面胶带相同，仅压合即可粘贴。

feature 03

通过添加不同化合物的粘合剂种类，还可赋予胶带低介电性
等各种机能

化合物

+

粘合剂种类	基材	厚度
· 亚克力系 · 橡胶系 · 低介电 · 耐热 · 耐药 etc	· 无基材 · PET基材 · 无纺布 · PE FOAM etc	· 无基材 · PET基材 · 无纺布 · PE FOAM etc

可根据
用途应对



粘接

FA/FB系列 – 用于氟树脂的双面胶带



安全 (ADAS)



环境

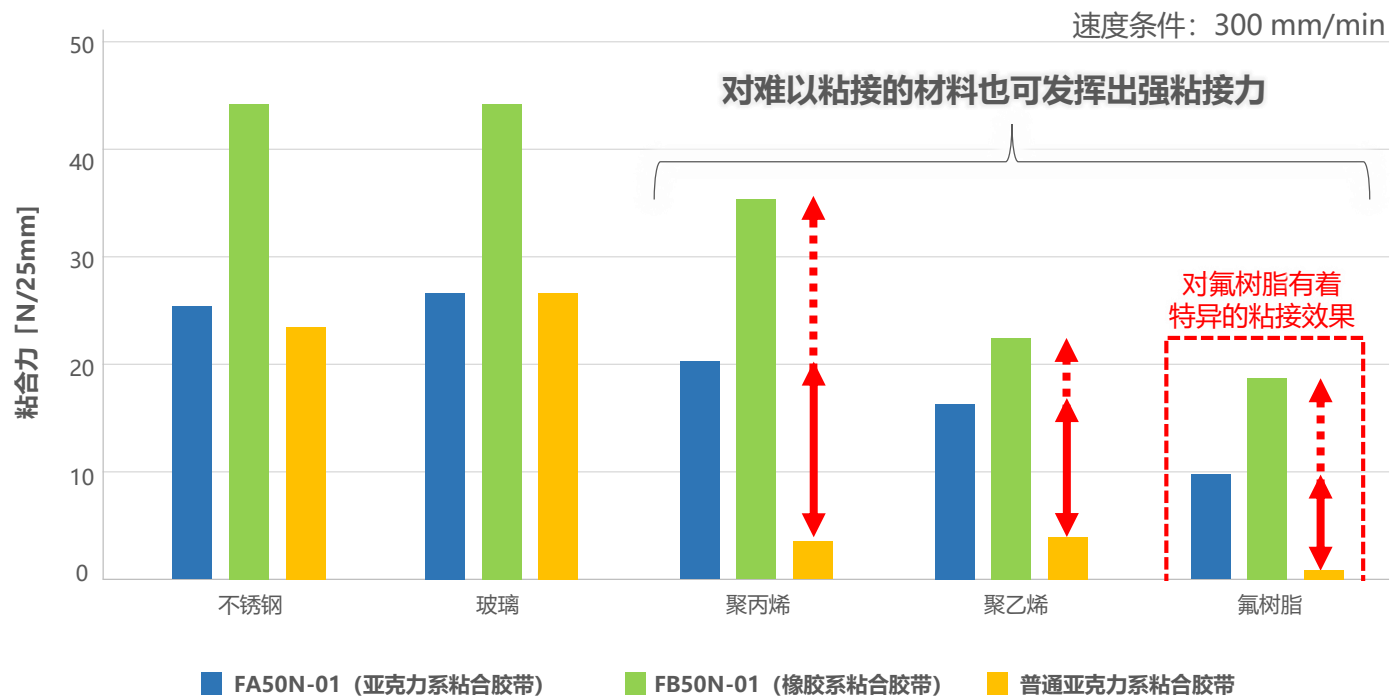


设计/舒适

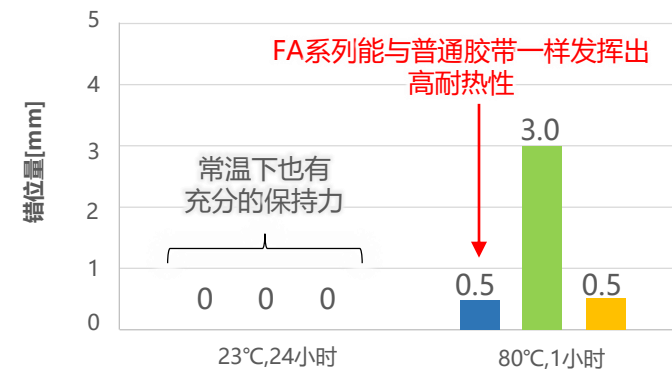
技术数据

feature
01

180°Peel试验

feature
02

保持力

feature
03

介电特性 (10GHz)

